03. 8. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2003年 7月30日

出願番号 Application Number: 特願2003-282961

[ST. 10/C]:

[JP2003-282961]

REC'D **24 SEP 2004**WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

40 No

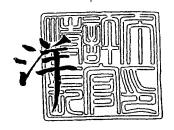
住友電気工業株式会社 住友電工焼結合金株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 9月 9日





```
特許願
【書類名】
              1031210
【整理番号】
              平成15年 7月30日
【提出日】
              特許庁長官殿
【あて先】
              H01F 1/33
【国際特許分類】
              H01F 41/02
【発明者】
              兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 伊
   【住所又は居所】
              丹製作所内
              豊田 晴久
   【氏名】
【特許出願人】
              000002130
   【識別番号】
              大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
   【住所又は居所】
              住友電気工業株式会社
   【氏名又は名称】
【代理人】
              100064746
   【識別番号】
   【弁理士】
              深見 久郎
   【氏名又は名称】
【選任した代理人】
              100085132
   【識別番号】
   【弁理士】
              森田 俊雄
   【氏名又は名称】
 【選任した代理人】
   【識別番号】
               100083703
   【弁理士】
               仲村 義平
   【氏名又は名称】
 【選任した代理人】
               100096781
   【識別番号】
    【弁理士】
               堀井 豊
    【氏名又は名称】
 【選任した代理人】
    【識別番号】
               100098316
    【弁理士】
               野田 久登
    【氏名又は名称】
 【選任した代理人】
    【識別番号】
               100109162
    【弁理士】
               酒井 將行
    【氏名又は名称】
 【手数料の表示】
    【予納台帳番号】
               008693
               21,000円
    【納付金額】
 【提出物件の目録】
               特許請求の範囲 1
    【物件名】
               明細書 1
    【物件名】
```

図面 1

要約書 1

9908053

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

金属磁性粒子、前記金属磁性粒子の表面を取り囲む絶縁被膜とを含む複数の複合磁性粒 子と、

前記複数の複合磁性粒子を互いに接合する有機物とを備え、

前記有機物の荷重たわみ温度は、100℃以下である、軟磁性材料。

【請求項2】

軟磁性材料に対する前記有機物の割合は、0を超え1.0質量%以下である、請求項1 に記載の軟磁性材料。

【請求項3】

8. 0×10^3 (A/m) の磁場を印加した場合の磁束密度が1.3 (T:テスラ)以 上である、請求項2に記載の軟磁性材料。

【請求項4】

請求項1から3のいずれか1項に記載の軟磁性材料を用いて作製された、圧粉磁心。

【請求項5】

金属磁性粒子および前記金属磁性粒子の表面を取り囲む絶縁被膜を含む複数の複合磁性 粒子と、荷重たわみ温度が100℃以下である有機物とを混合することによって混合体を 形成する工程と、

前記混合体を加圧成形することによって成形体を形成する工程とを備える、軟磁性材料 の製造方法。

【請求項6】

前記有機物のガラス転移温度を超え、前記有機物の熱分解温度以下の温度で、前記成形 体を熱処理する工程をさらに備える、請求項5に記載の軟磁性材料の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】軟磁性材料、圧粉磁心および軟磁性材料の製造方法

【技術分野】

[0001]

この発明は、一般的には、軟磁性材料、圧粉磁心および軟磁性材料の製造方法に関し、 より特定的には、金属磁性粒子と、その金属磁性粒子を覆う絶縁被膜とによって構成され た複合磁性粒子を備える軟磁性材料、圧粉磁心および軟磁性材料の製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、モーターコアやトランスコアなどの電気電子部品において高密度化および小型化 が図られており、より精密な制御を小電力で行えることが求められている。このため、こ れらの電気電子部品の作製に使用される軟磁性材料であって、特に中高周波領域において 優れた磁気的特性を有する軟磁性材料の開発が進められている。

[0003]

このような軟磁性材料に関して、たとえば、特開2002-246219号公報には、 高い温度環境下の使用に際しても磁気特性が維持できることを目的とした圧粉磁心および その製造方法が開示されている(特許文献1)。特許文献1に開示された圧粉磁心の製造 方法によれば、まず、リン酸被膜処理アトマイズ鉄粉に所定量のポリフェニレンサルファ イド(PPS樹脂)を混合し、これを圧縮成形する。さらに、得られた成形体を所定の温 度で加熱し、冷却することによって圧粉磁心を作製する。

【特許文献1】特開2002-246219号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

上述の製造方法によって作製された圧粉磁心の実効透磁率は、50Hzの周波数におい て、PPS樹脂の含有量の増加に対してほぼ直線的に低下する。また、5000Hzの周 波数において圧粉磁心の実効透磁率は、PPS樹脂を含まないものは低く、PPS樹脂の 含有量が0.3質量%近傍で最大となり、それ以上のPPS樹脂を含むと、50Hzの周 波数の場合と同様に低下する。

[0005]

このようにPPS樹脂の含有量を増加させると、全体に占める鉄基の割合が減少するた め、圧粉磁心の実効透磁率が低下するという問題が生じる。また、PPS樹脂の含有量が 少なすぎると、高周波を印加した場合に、リン酸被膜処理アトマイズ鉄粉の粒子間渦電流 損が増大し、圧粉磁心の実効透磁率が低下するという問題が生じる。このような問題を解 決するためには、アトマイズ鉄粉を覆うリン酸被膜を絶縁層として十分に機能させ、PP S樹脂の含有量にかかわらず粒子間渦電流の発生を確実に抑制することが必要である。

[0006]

そこでこの発明の目的は、上記の課題を解決することであり、所望の磁気的特性を有す る軟磁性材料、圧粉磁心および軟磁性材料の製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0007]

この発明に従った軟磁性材料は、金属磁性粒子と、金属磁性粒子の表面を取り囲む絶縁 被膜とを含む複数の複合磁性粒子と、複数の複合磁性粒子を互いに接合する有機物とを備 える。有機物の荷重たわみ温度 (1. 82MPa負荷時) は、100℃以下である。

[0008]

荷重たわみ温度(熱変形温度)とは、JIS K 7207-1983に規定されている 荷重たわみ温度試験方法によって測定される温度をいう。この試験方法では、試験片の両 端を加熱浴槽中で支え、中央の荷重棒によって試験片に所定の曲げ応力を加えつつ、伝達 媒体の温度を $2 \, \mathbb{C} / \mathcal{G}$ の速度で上昇させる。そして、試験片のたわみが所定の値に達した ときの伝達媒体の温度をもって、その試験片を構成する材料の荷重たわみ温度とする。

[0009]

このように構成された軟磁性材料によれば、複数の複合磁性粒子と有機物との混合体を 加圧成形する際、加圧により発生する熱によって、混合体の温度は、100℃に近い温度 にまで上昇する。このとき、有機物の荷重たわみ温度(1.82MPa負荷時)が100 ℃以下であるため、複数の複合磁性粒子間で有機物が緩衝材としての役割を果たす。この 有機物の働きにより、加圧成形時、複合磁性粒子同士が擦れあって、金属磁性粒子の表面 を取り囲む絶縁被膜に局所的な力が加わることを防止できる。これにより、加圧成形後も 絶縁被膜による金属磁性粒子間の絶縁性が維持され、粒子間渦電流の発生が抑制される。 したがって、本発明によれば、高周波数の交流磁場を印加した場合にも透磁率の低下が抑 制される軟磁性材料を実現することができる。

[0010]

また好ましくは、軟磁性材料に対する有機物の割合は、0を超え1.0質量%以下であ る。このように構成された軟磁性材料によれば、有機物が緩衝材としての役割を果たす一 方、軟磁性材料に占める金属磁性粒子の割合が小さくなりすぎることがない。このため、 粒子間渦電流の発生を抑制しつつ、所定値以上の磁束密度を得ることができる。

[0011]

さらに好ましくは、軟磁性材料に対する有機物の割合は、0を超え0.5質量%以下で ある。また、さらに好ましくは、軟磁性材料に対する有機物の割合は、0を超え0.3質 量%以下である。このように構成された軟磁性材料によれば、軟磁性材料に占める金属磁 性粒子の割合を大きくすることによって、より高い値の磁束密度を得ることができる。

[0012]

また好ましくは、軟磁性材料に対する有機物の割合が、0を超え1.0質量%以下であ る時、8.0imes10 3 (A/m)の磁場を印加した場合の磁束密度が1.3 (T:テスラ)以上である。

[0013]

この発明に従った圧粉磁心は、上述のいずれかに記載の軟磁性材料を用いて作製された 圧粉磁心である。このように構成された圧粉磁心によれば、髙周波数の交流磁場を印加し た場合にも透磁率の低下が抑制されるという上述の効果を得ることができる。

[0014]

この発明に従った軟磁性材料の製造方法は、金属磁性粒子および金属磁性粒子の表面を 取り囲む絶縁被膜を含む複数の複合磁性粒子と、荷重たわみ温度(1.82MPa負荷時)が100℃以下である有機物とを混合することによって混合体を形成する工程と、混合 体を加圧成形することによって成形体を形成する工程とを備える。

[0015]

このように構成された軟磁性材料の製造方法によれば、成形体を形成する工程時、加圧 により発生する熱によって、混合体の温度は、100℃に近い温度にまで上昇する。この とき、有機物の荷重たわみ温度 (1.82MPa負荷時) が100℃以下であるため、複 数の複合磁性粒子間で有機物が緩衝材としての役割を果たす。この有機物の働きにより、 複合磁性粒子同士が擦れあって、金属磁性粒子の表面を取り囲む絶縁被膜に局所的な力が 加わることを防止できる。これにより、加圧成形後も、絶縁被膜による金属磁性粒子間の 絶縁性が維持され、粒子間渦電流の発生が抑制される。したがって、本発明によれば、高 周波数の交流磁場を印加した場合にも透磁率の低下が抑制される軟磁性材料を実現するこ とができる。

[0016]

また好ましくは、軟磁性材料の製造方法は、有機物のガラス転移温度を超え、有機物の 熱分解温度以下の温度で、成形体を熱処理する工程をさらに備える。ガラス転移温度とは 、無定形高分子物質が温度の上昇によってガラス状の固体からゴム状の状態に移る温度を いう。なお、有機物の種類によっては、ガラス転移温度が明確に特定されない場合がある が、この場合、ガラス転移温度にかえて有機物の融点によって熱処理温度を設定すれば良 1,20

[0017]

このように構成された軟磁性材料の製造方法によれば、有機物の熱分解を抑制するとともに、有機物を複数の複合磁性粒子間の空間に適合する形状に変形し、その空間に浸入させることができる。これにより、有機物による複合磁性粒子間の接合をより確実にし、成形体の強度を向上させることができる。

【発明の効果】

[0018]

以上説明したように、この発明に従えば、所望の磁気的特性を有する軟磁性材料、圧粉 磁心および軟磁性材料の製造方法を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0019]

この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

[0020]

図1は、この発明の実施の形態における軟磁性材料を拡大して示す模式図である。図1 を参照して、軟磁性材料は、金属磁性粒子10と、金属磁性粒子10の表面を取り囲む絶 縁被膜20とから構成された複数の複合磁性粒子30を備える。

[0021]

複数の複合磁性粒子30の間には、荷重たわみ温度(1.82MPa負荷時)が100 ℃以下である有機物40が介在している。一般的に、荷重たわみ温度は、ガラス転移温度 より高い値を示す。複数の複合磁性粒子30の各々は、有機物40によって接合されてい たり、複合磁性粒子30が有する凹凸の噛み合わせによって接合されている。

[0022]

金属磁性粒子10は、たとえば、鉄(Fe)、鉄(Fe)ーシリコン(Si)系合金、鉄 (Fe)ー窒素 (N) 系合金、鉄 (Fe)ーニッケル (Ni) 系合金、鉄 (Fe)ー炭素 (C) 系合金、鉄 (Fe)ーホウ素 (B) 系合金、鉄 (Fe)ーコバルト (Co)系合金、鉄 (Fe)ーリン (P)系合金、鉄 (Fe)ーニッケル (Ni)ーコバルト (Co)系合金および鉄 (Fe)ーアルミニウム (Al)ーシリコン (Si)系合金などから形成することができる。金属磁性粒子10は、金属単体でも合金でもよい。

[0023]

金属磁性粒子10の平均粒径は、 5μ m以上 200μ m以下であることが好ましい。金属磁性粒子10の平均粒径を 5μ m以上にした場合、金属が酸化されにくいため、軟磁性材料の磁気的特性を向上させることができる。また、金属磁性粒子10の平均粒径を 200μ m以下にした場合、後に説明する成形工程時において混合粉末の圧縮性が低下するということがない。これにより、成形工程によって得られた成形体の密度を大きくすることができる。

[0024]

なお、ここで言う平均粒径とは、ふるい法によって測定した粒径のヒストグラム中、粒径の小さいほうからの質量の和が総質量の50%に達する粒子の粒径、つまり50%粒径 Dをいう。

[0025]

絶縁被膜20は、金属磁性粒子10をリン酸処理することによって形成することができる。また好ましくは、絶縁被膜20は、酸化物を含有する。この酸化物を含有する絶縁被膜20としては、リンと鉄とを含むリン酸鉄の他、リン酸マンガン、リン酸亜鉛、リン酸カルシウム、酸化シリコン、酸化チタン、酸化アルミニウムまたは酸化ジルコニアなどの酸化物絶縁体を使用することができる。

[0026]

絶縁被膜 20 は、金属磁性粒子 10 間の絶縁層として機能する。金属磁性粒子 10 を絶縁被膜 20で覆うことによって、軟磁性材料の電気抵抗率 ρ を大きくすることができる。これにより、金属磁性粒子 10 間に渦電流が流れるのを抑制して、渦電流に起因する軟磁性材料の鉄損を低減させることができる。

[0027]

絶縁被膜20の厚みは、0.005μm以上20μm以下であることが好ましい。絶縁 被膜 20 の厚みを 0.005 μ m以上とすることによって、渦電流によるエネルギー損失 を効果的に抑制することができる。また、絶縁被膜20の厚みを20μm以下とすること によって、軟磁性材料に占める絶縁被膜20の割合が大きくなりすぎることがない。この ため、軟磁性材料の磁束密度が著しく低下することを防止できる。

[0028]

有機物40は、たとえば、荷重たわみ温度が50℃であるポリテトラフルオロエチレン (テフロン(登録商標))、荷重たわみ温度が60℃である6−12ナイロン、荷重たわ み温度が65℃である6ナイロン、荷重たわみ温度が70℃である6−6ナイロン、荷重 たわみ温度が78℃であるポリプチレンテレフタレート (PBT) および荷重たわみ温度 が85℃であるポリフェニレンエーテル (PPE) などから形成することができる。なお 、ここに挙げた荷重たわみ温度は、1.82MPa負荷時の代表値であり、測定時の誤差 によって多少の違いが生じるものと考えられる。

[0029]

軟磁性材料に対する有機物40の割合は、0を超え1.0質量%以下であることが好ま しい。このとき、100(エルステッド)の磁場を印加した場合の磁束密度B100が、 1.3 (テスラ)以上となる。有機物40の割合を1.0質量%以下とすることによって 、軟磁性材料に占める金属磁性粒子10の割合を一定以上に確保することができる。これ により、より高い磁束密度の軟磁性材料を得ることができる。

[0030]

また、軟磁性材料に対する有機物40の割合は、0を超え0.5質量%以下であること がさらに好ましい。このとき、100(エルステッド)の磁場を印加した場合の磁束密度 B100が、1.4 (テスラ)以上となる。

[0031]

続いて、図1中の軟磁性材料の製造方法について説明を行なう。まず、金属磁性粒子1 0の表面に絶縁被膜20を形成することによって、複合磁性粒子30を作製する。

[0032]

次に、複合磁性粒子30と有機物40とを混合することによって混合粉末を得る。なお 、混合方法に特に制限はなく、たとえばメカニカルアロイング法、振動ボールミル、遊星 ボールミル、メカノフュージョン、共沈法、化学気相蒸着法(CVD法)、物理気相蒸着 法(PVD法)、めっき法、スパッタリング法、蒸着法またはゾルーゲル法などのいずれ を使用することも可能である。

[0033]

次に、得られた混合粉末を金型に入れ、たとえば、700MPaから1500MPaま での圧力で加圧成形する。これにより、混合粉末が圧縮されて成形体が得られる。加圧成 形する雰囲気は、不活性ガス雰囲気または減圧雰囲気とすることが好ましい。この場合、 大気中の酸素によって混合粉末が酸化されるのを抑制できる。

[0034]

加圧成形の際、混合粉末の温度は100℃程度まで上昇する。一方、この温度条件下で 、荷重たわみ温度(1.82MPa負荷時)が100℃以下である有機物40は、応力を 受ければある程度たわむ状態となっている。このため、有機物40は、複合磁性粒子30 の間で緩衝材として機能し、複合磁性粒子30同士の接触によって絶縁被膜20が破壊さ れることを防ぐ。

[0035]

次に、加圧成形によって得られた成形体を、有機物40のガラス転移温度を超え、有機 物40の熱分解温度以下の温度で熱処理する。これにより、有機物40が熱分解されるの を抑制しつつ、有機物40を複合磁性粒子30間に入り込ませることができる。また別に 、加圧成形時に成形体の内部に発生した歪および転位を取り除くことができる。以上に説 明した工程により、図1中の軟磁性材料が完成する。

[0036]

このように構成された軟磁性材料およびその製造方法によれば、所定の荷重たわみ温度 を有する有機物40の働きによって絶縁被膜20を傷付けず加圧成形を行なうことができ るため、絶縁被膜20を金属磁性粒子10間の絶縁層として十分に機能させることができ る。これにより、粒子間渦電流損の発生を確実に抑制し、軟磁性材料に高周波数の交流磁 場を印加した場合にも、透磁率の低下を抑えることができる。なお、このような性質を備 える軟磁性材料を、たとえば、圧粉磁心、チョークコイル、スイッチング電源素子、磁気 ヘッド、各種モータ部品、自動車用ソレノイド、各種磁気センサおよび各種電磁弁などに 使用することができる。

【実施例】

[0037]

以下に説明する実施例によって、本発明による軟磁性材料の評価を行なった。

[0038]

実施の形態に記載の製造方法に従って、図1中の軟磁性材料を作製した。この際、複合 磁性粒子30として、ヘガネス社製の商品名「ソマロイ500」を用いた。この粉末では 、金属磁性粒子としての鉄粉の表面に、絶縁被膜としてのリン酸化合物被膜が形成されて いる。鉄粉の平均粒径は150μm以下であり、リン酸化合物被膜の平均厚みは20nm である。

[0039]

また、有機物40には、テフロン(登録商標)としてダイキン社製の商品名「ルブロン L5]、6-12ナイロンとしてデュポン社製の商品名「ザイテル151L」、6ナイロ ンとしてユニチカ社製の商品名「A1030BRL」、6-6ナイロンとして旭化成社製 の商品名「1300S」、PBTとしてポリプラスチックス社製の商品名「ジュラネック ス2002」、およびPPEとして旭化成社製の「ザイロン100V」を用いた。

[0040]

さらに、本発明の効果を確認するため、荷重たわみ温度 (1.82MPa負荷時)が1 00℃を超える有機物40を用いて軟磁性材料を作製した。この場合、有機物40には、 POM:ポリアセタール樹脂としてポリプラスチックス社製の商品名「ジュラコンM90 S」、PPS:ポリフェニレンサルファイドとして日本ポリペンコ社製の商品名「テクト ロンPPS」、GE社製の商品名「ウルテム」、および宇部興産社製の商品名「UPI-R」を使用した。「UPI-R」は、化学的にはビフェニルテトラカルボン酸二無水物を 用いた全芳香族ポリイミドである。

[0041]

有機物40の割合は、0.01質量%から1質量%まで変化させた。また、加圧成形時 の圧力を900MPaとし、熱処理時の条件を、250℃から300℃の温度で1時間と した。

[0042]

続いて、得られた軟磁性材料に対して、50Hzから100000Hzの範囲で周波数 を変えて交流磁場を常温で印加し、各周波数における透磁率μAを測定した。そして、5 $0~{
m H}~z$ の交流磁場を印加した場合の透磁率を $\mu~{
m B}$ として $\mu~{
m A}/\mu~{
m B}$ を求め、周波数を上げ ることによってどの程度透磁率が減少するかを調べた。図2は、この実施例において、透 磁率の減少率μΑ/μΒと各周波数との関係を示すグラフである。図2では、有機物40 の割合が0.1質量%の場合のものを示した。

[0043]

また、測定によって得られた透磁率μAが、50Hzの交流磁場を印加した場合の透磁 率μΒの5%減となる周波数を求め、絶縁被膜20の種類、有機物40の割合ごとに表1 および図3に示した。図3は、この実施例において、透磁率μΑの5%減周波数と有機物 の荷重たわみ温度との関係を示すグラフである。図3では、表1に示す結果のうち、特に 有機物40の割合が0.1質量%の場合のものを示した。

[0044]

【表1】

	有機物	*********	μ A5%減周波数 (Hz)				
		荷重たわみ 温度(℃)	0.01 (質量%)	0.05 (質量%)	0.1 (質量%)	0.3 (質量%)	
実施品	テフロン (登録商標)	50	10, 141	11, 660	14, 758	34, 611	
	6-12 ナイロン	60	3,020	5, 750	10, 823	15, 754	
	6 ナイロン	65	1, 953	2, 888	5, 142	10, 788	
	6-6 ナイロン	70	1,631	2, 412	4, 295	10, 121	
	PBT	78	1, 240	1, 834	3, 266	7, 419	
	PPE	85	1,010	1, 494	2, 659	5, 876	
比較品	POM	110	552	883	1, 369	2, 766	
	PPS	121	379	607	940	2, 306	
	からん(商品名)	200	81	170	201	375	
	UPI-R(商品名)	360	59	120	147	330	

[0045]

図2を参照して、本発明の実施品では、周波数が10000Hzを超える程度まで、透 磁率μAがほとんど減少しないことが分かった。表1および図3を参照して、荷重たわみ 温度が低いほど透磁率 μ A の 5 % 減周波数は大きくなり、特に、 6-1 2 ナイロンを有機 物40に用いた実施品では、10000Hzを超える周波数、テフロン(登録商標)を有 機物40に用いた実施品では、15000Hz程度の周波数でも実質的に問題ないことが 分かった。

[0046]

続いて、軟磁性材料に100 (エルステッド)の磁場を印加して、その時の磁束密度B 100を測定した。測定した結果を、絶縁被膜20の種類、有機物40の割合ごとに表2 に示した。

[0047] 【表2】

ГТ		荷重	磁束密度 B100 (テスラ)					
	有機物	たわみ 温度(℃)	0.01	0.1 (質量%)	0.3	0.5	0.7 (質量%)	0.13 (質量%)
実施品	テフロン (登録商 標)	50	1.55	1.54	1.51	1.49	1. 46	1.43
	6-12 ナイロン	60	1.54	1.53	1.51	1.47	1,44	1.40
	6 ナイロン	65	1.55	1.53	1.50	1.48	1, 43	1.40
	6-6ナイロン	70	1.53	1.52	1.49	1.44	1.42	1.36
	PBT	78	1, 52	1.51	1.46	1.43	1, 38	1.33
	PPE	85	1.52	1.51	1.47	1.42	1, 39	1.32
比較品	POM	110	1.53	1.50	1.43	1.38	1, 34	1.24
	PPS	121	1. 53	1.52	1.44	1.38	1. 32	1. 23

[0048]

表2を参照して、本発明の実施品では、有機物40の割合が1質量%以下である場合、 1.3 (テスラ)以上の磁束密度を得ることができ、さらに、有機物40の割合が0.5 質量%以下である場合、1.4 (テスラ)以上の磁束密度を得ることができることを確認 できた。

[0049]

以上の結果から、本発明に従えば、有機物40の割合をできるだけ小さくして高い磁束 密度を得る一方で、有機物40の割合が小さくても、より高い透磁率を高周波側まで維持 できる軟磁性材料を作製できることを確認できた。

[0050]

今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ とが意図される。

【図面の簡単な説明】

[0051]

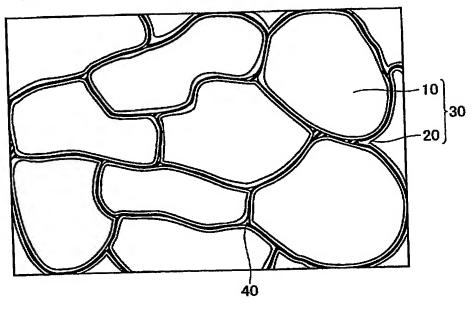
- 【図1】この発明の実施の形態における軟磁性材料を拡大して示す模式図である。
- 【図2】この実施例において、透磁率の減少率μA/μBと各周波数との関係を示す グラフである。
- 【図3】この実施例において、透磁率μAの5%減周波数と有機物の荷重たわみ温度 との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

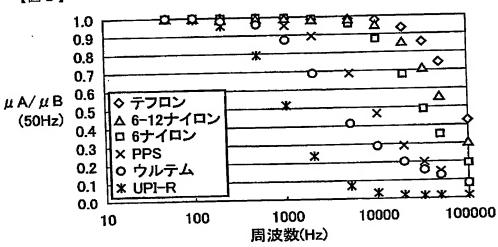
[0052]

10 金属磁性粒子、20 絶縁被膜、30 複合磁性粒子、40 有機物。

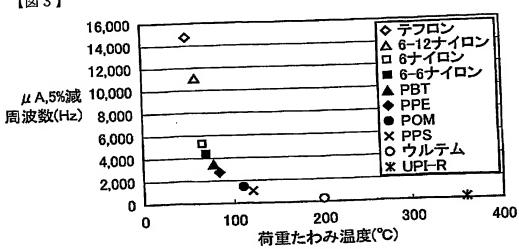
【書類名】図面【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 所望の磁気的特性を有する軟磁性材料、圧粉磁心および軟磁性材料の製造方法 を提供する。

軟磁性材料は、金属磁性粒子10と、金属磁性粒子10の表面を取り囲む 【解決手段】 絶縁被膜20とを含む複数の複合磁性粒子30と、複数の複合磁性粒子30を互いに接合 する有機物40とを備える。有機物40の荷重たわみ温度は、100℃以下である。

【選択図】

図 1

出願人名義変更届 【書類名】 1031210 【整理番号】 平成16年 3月19日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 【事件の表示】 特願2003-282961 【出願番号】 【承継人】 【識別番号】 593016411 岡山県川上郡成羽町大字成羽2901番地 【住所又は居所】 住友電工焼結合金株式会社 【氏名又は名称】 【承継人代理人】 【識別番号】 100064746 【弁理士】 深見 久郎 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100085132 【識別番号】 【弁理士】 森田 俊雄 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100083703 【識別番号】 【弁理士】 仲村 義平 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100096781 【識別番号】 【弁理士】 堀井 豊 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100098316 【識別番号】 【弁理士】 野田 久登 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 100109162 【弁理士】 酒井 將行 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 008693 4,200円 【納付金額】 【提出物件の目録】

【物件名】

【提出物件の特記事項】

【包括委任状番号】 0313062

承継人であることを証明する書面 1

手続補足書にて提出

特願2003-282961

出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名 住友電気工業株式会社

特願2003-282961

出願人履歴情報

識別番号

[593016411]

1. 変更年月日

2003年 7月16日

[変更理由]

住所変更

住所

岡山県川上郡成羽町大字成羽2901番地

氏 名 住友智

住友電工焼結合金株式会社